



3D Heterogeneous Integration Alliance

第5回研究会

3 DHIアライアンス第5回研究会

- 半導体市況回復とチップレットデザインの方向性について -

12:45

開場

13:00 ~ 13:45 「3D-IC/chiplet設計を支援する半導体/PKG/PCB協調設計環境」

株式会社図研 技術本部

シニアパートナー 松澤 浩彦 氏

13:45 ~ 14:30 「次世代コンピューティング向けアドバンスドヘテロジニアスインテグレーション
プラットフォーム ”ムーアの法則を超えて」

日本サムソン株式会社 デバイスソリューション研究所 Advanced Package Lab.

Corporate Vice President Lab長 苅谷 隆 氏

14:30 ~ 15:15 「チップレット - アーキテクチャの方向性とエコシステム -」

産業技術総合研究所 AIチップ設計拠点 拠点長 内山 邦男 氏

15:15 ~ 15:30 休憩

15:30 ~ 16:15 「半導体産業の新たな成長シナリオが動き出した」

インフォマインテリジェンス合同会社

Senior Consulting Director, Component and Devices 南川 明 氏

16:15 ~ 17:00 「SQIE(半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター) のアップデート」と「3 DHI事務局から
のご報告及びご連絡」

3DHI代表 井上 史大 氏

3DHI事務局長 島内 秀 氏

17:00 ~ 17:30 「名刺交換会 (会場のみ)」